

注記 NOTES
1. 嵌合相手: 52465,52588
MATE WITH: 52465,52588 SERIES
△ ウェハーの ϕ から隣接するピンの ϕ 迄の位置を示す。
SHOW POSITION FROM ϕ OF WAFER TO ϕ OF ADJACENT PINS.

0.4	17.8	16.9	15.2	53307-4027	40
0.4	16.2	15.3	13.6	-3627	36
0.8	15.4	14.5	12.8	-3427	34
0.8	13.8	12.9	11.2	-3027	30
0.4	13.0	12.1	10.4	-2827	28
0.8	12.2	11.3	9.6	-2627	26
0.4	11.4	10.5	8.8	-2427	24
0.8	10.6	9.7	8.0	-2227	22
0.4	9.8	8.9	7.2	-2027	20
0.8	9.0	8.1	6.4	-1827	18
0.4	8.2	7.3	5.6	-1627	16
0.8	7.4	6.5	4.8	-1427	14
0.4	6.6	5.7	4.0	-1227	12
0.8	5.8	4.9	3.2	53307-1027	10
D	C	B	A	ENG. NO.	極数 CKT.

角度 ANGLE	$\pm 3^\circ$				
30以上 OVER	+0.3	B	変更 REVISION (JCT0882)	97/4/1	
10以上 30未満 UNDER	+0.25	A	変更 REVISION (JC60094)	95/8/9	
10未満 UNDER	+0.2	O	新規作成 PROPOSED (J1100)	91/11/16	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. DATE	日付 DATE

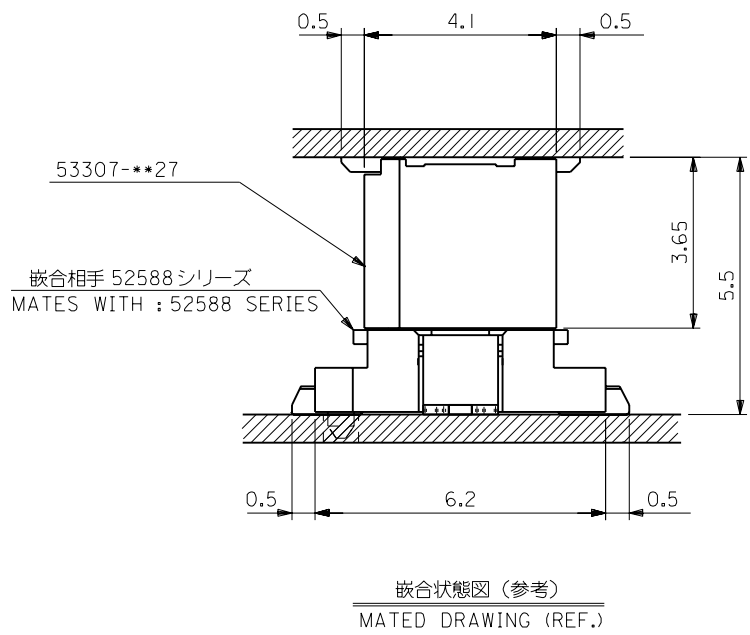
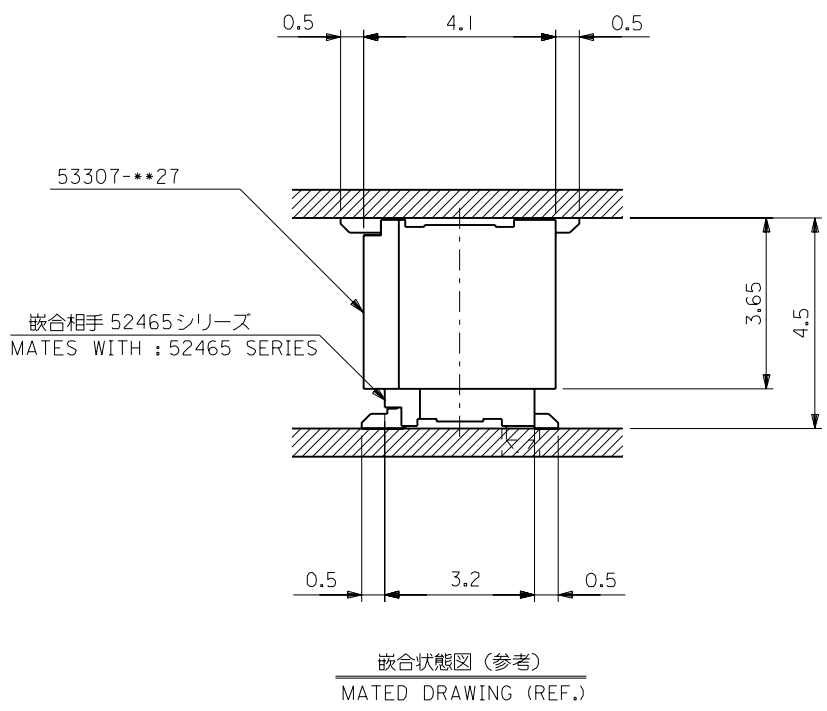
材料 MATERIAL	☑中参照 SEE DRAWING
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY '91/11/14	CHK'D BY '97/4/1
K.ASAKAWA	Y.MIZUNO
APP'D BY '97/4/1	尺 寸 尺 度
M.FUKUSHIMA	—

molex MOLEX-JAPAN CO.,LTD.
日本モレックス株式会社

REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称

0.8 BOARD TO BOARD CONN.
WAFER ASS'Y ST. SMT
(WITHOUT BOSS)

DWG. NO. (SHEET 1 OF 2) REV
SD-53307-**-27 B



角度 ANGLE		13.5°				材料 MATERIAL		MOLEX-JAPAN CO.,LTD. 日本モレックス株式会社	
30以上 OVER		+0.3		B 変更 REVISD(JC70882)		SHEET 1 OF 2参照 REFER TO SHEET 1 OF 2		REVISE ONLY ON CAD SYSTEM	
10以上 30未満 OVER UNDER		+0.25		A 変更 REVISD(JC60094)		仕上げ FINISH		TITLE 名称	
10未満 UNDER		+0.2		O 新規作成 (J11001)		適用電線範囲 WIRE RANGE		0.8 BOARD TO BOARD CONN. WAFER ASS'Y ST. SMT (WITHOUT BOSS)	
一般公差 GENERAL TOLERANCES		記号 LTR		変更内容 REVISION RECORD		DR. CHK. 日付 DATE		DWG. NO. (SHEET 2 OF 2) REV	
						DRAWN BY '91/11/14 K.ASAKAWA		SD-53307-**-27 B	
						CHK'D BY '97/4/1 Y.MIZUNO			
						APP'D BY '97/4/1 M.FUKUSHIMA			
						尺度 SCALE			